

元器件生产厂商自查承诺书

依据 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》和 ZKB 3101-002-2022《武器装备使用国产电子元器件“伪、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求，对我单位研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共 3 项，其中自主可控 A 级 0 项、B 级 3 项、C 级 0 项、C*级 0 项、D 级 0 项、E 级 0 项；伪国产化 0 项、包装国产化 0 项、空心国产化 0 项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表 1；电子元器件使用 IP 核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表 2。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。

特此承诺。



附表 1 电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

序号	一级分类	二级分类	三级分类	元器件名称	型号规格	生产厂商	自主可控等级	是否“伪国产化”		是否“包装国产化”		是否“空心国产化”		备注
								是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	半导体集成电路	放大器件	/	运算放大器	JTLX8452PXK	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
2	半导体集成电路	放大器件	/	运算放大器	JTLX8452PXK(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
3	半导体集成电路	放大器件	/	运算放大器	TLX8452PXK	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	

填报单位（盖章）： 法定代表人（签章）：汤学明 填表人（签字）：侯仕颖 电话：13699386074 填报日期：2026-07-30

填表说明：

- 1. 一级、二级、三级分类按 ZKB 3101-002-2022 附录 A 填写
- 2. 元器件名称：应填写元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；
- 3. 型号规格：应填写元器件完整型号规格；
- 4. 生产厂商：应填写元器件生产厂商中文全称，勿填写代理商；
- 5. 伪空包：按照 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》执行，分为 A、B、C、C*、D、E 六个等级，针对为军选民用计算机设备配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照 GJB 9530-2018 执行；
- 6. “伪、空、包”应按照 ZKB 3101-002-2022 标准执行。若为“是”时，则需要在“情况说明”写明判别因素；若为“否”时，则填“无”；
- 7. 若存在其他需要说明的情况，可在备注栏填写。

附表 2 电子元器件基本信息表

序号	一级分类	二级分类	三级分类	元器件名称	型号规格	使用 IP 核情况				原材料和零部件				流片工艺		备注
						名称	类型	来源单位	境内/境外	名称	是否核心/关键	来源单位	境内/境外	工艺名称	境内/境外	
1	半导体集成电路	放大器件	/	运算放大器	JTLX8452PXK	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.8um BCD	境内	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
2	半导体集成电路	放大器件	/	运算放大器	JTLX8452PXK(W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.8um BCD	境内	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
3	半导体集成电路	放大器件	/	运算放大器	TLX8452PXK	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.8um BCD	境内	
						IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				



填报单位（盖章）： 法定代表人（签章）： 侯仕颖 填表人（签字）： 侯仕颖 电话：13699386074 填报日期：2026-07-30

填表说明： 3202110176104

1. 一级、二级、三级分类按 ZKB 3101-002-2022 附录 A 填写

2. 元器件名称：应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；

3. 型号规格：应填写元器件完整型号规格；

4. 使用 IP 核情况：仅适用于半导体集成电路，应填写 IP 核类型，包括“软核”“固核”“硬核”；

5. 原材料和零部件：本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写，至少包含 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 中内 6. 部零部件或原材料，同时也应包含外壳、引出端、键合丝等，不包含灌封料等生产过程材料；

6. 是否“核心”/“关键”：应根据 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 填写“核心”或“关键”，非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填；

7. 来源单位：应根据实际设计单位或生产商情况填写，不能按代理商填写；对来源不明的，应填写“来源不明”，具体判定时视为“境外”；

8. 流片工艺：仅适用于半导体集成电路，应填写流片工艺名称，如 45nmBCD 工艺等；

9. 若存在其他需要说明的情况，可在备注栏填写。